



エレクトロニクス実装学会 - 関西ワークショップ 2009 -

開催日：2009 年 7 月 10 日（金）

会 場：コープ・イン京都

ピンチをチャンスに !!

実装技術からの新ビジネス発掘

特 別 講 演

★08 年後半以降の環境激変の要因分析と今後の展望

後藤文人（UBS 証券）

★部品内蔵基板の動向

猪川幸司（日本 CMK）

ポ ス タ ー 講 演

基板・部品内蔵基板、新工法、
新材料、新パッケージング、
MEMS 分野から 18 件。

（詳細は裏面をご覧ください）

エレクトロニクス実装学会主催、
関西ワークショップを例年通り京都
で開催いたします。今回、左記
特別講演2件を企画するとともに、
実装技術の現状と将来像を自由
に討論できる場として、学会形式
とは異なった 1 対1での質問 / 意
見交換が可能なポスターセッション
で開催いたします。

実行委員長 菅野公二（京都大学）

■問い合わせ先

事務局：（社）エレクトロニクス実装学会

〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3-12-2

TEL:03-5310-2010 FAX:03-5310-2011

URL: <http://www.e-jisso.jp>

◆ スケジュール

(時間は変更する場合があります。)

2009 年 7 月 10 日 (金)

- 10:00-10:05 開会の挨拶
10:05-11:00 ポスター講演アブストラクトトーク
(18 件)
11:00-13:00 特別講演 2 件
13:00-14:00 昼食
14:00-17:00 ポスター講演
(16:00-18:00 技術交流会)

◆ 参加費

(資料代、消費税含む)

正会員・賛助会員 19,000 円

一般 29,000 円

学生会員 1,000 円・学生非会員 3,000 円

◆ 定員

100 名

◆ 申込方法

下記の「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ学会事務局にファクシミリ (03-5310-2011) でお送りください。

◆ ポスター講演 (仮題含む、発表者敬称略)

部品内蔵・基板

1. 「部品内蔵配線板技術およびその電気特性」 ウェイスティー 福岡義孝
2. 「部品内蔵基板によるEMI低減効果について」 長野沖電気(株) 三浦雅広

新工法

3. 「True3次元貫通配線」 (株)フジクラ 脇岡寛之
4. 「Au ナノ粒子堆積による円錐形状バンプの形成とフリップチップ実装」 産業技術総合研究所 居村史人
5. 「サブトラクティブ法による銅の異方性エッチング」 メック(株) 戸田健次
6. 「自己組織化接合によるマイクロデバイスの積層システム化」 名古屋大学 安田清和

材料

7. 「照明用白色LEDパッケージ技術及び材料の紹介」 サンユレック(株) 宮脇善照
8. 「高演色白色 LED 実装のオンリー・ワン技術と新しい応用」 山口大学 田口常正
9. 「反応性誘起型層分材料を用いたダイボンディングフィルムの開発」 日立化成工業(株) 岩倉哲郎
10. 「常温下瞬間金属接合材」 (株)イトー 高橋隆一

パッケージ

11. 「IBM 3D 実装戦略を支える Key Technologies」 日本 IBM 折井靖光
12. 「両面電極 CSP による3D 実装の提案」 九州工業大学 石原政道
13. 「BG テープ一体型NCF」 積水化学工業(株) 李洋洙

MEMS

14. 「表面活性化低温接合により実現した超小型薄型光マイクロセンサ」 東京大学 日暮栄治
15. 「マイクロ・ナノ粒子配列化技術」 京都大学 平岡亮二
16. 「陽極接合による真空ウエハレベルパッケージの2軸光スキャナ」 パナソニック電工(株) 橋宏明
17. 「MEMS デバイスのパッケージング技術」 オムロン(株) 前川智史
18. 「温度制御転写を用いたマルチカラーLEDディスプレイ」 東京大学 岩瀬英治

最新情報は学会ホームページ (<http://www.e-jisso.jp/>) に掲載される予定です。

関西ワークショップ 2009 参加申込書【開催：2009 年 7 月 10 日】

学会事務局宛 (FAX 03-5310-2011)

ふりがな

氏名

勤務先

所属 (役職)

所在地 (〒)

TEL

FAX

E-mail

技術交流会 (参加費無料) ☐ 参加する ☐ 参加しない (いずれかにチェックをしてください。)

- 会員区分：☐ 正会員 (会員番号)
(レ印) ☐ 賛助会員 (会員番号)
☐ 一般
☐ 学生会員 (会員番号)
☐ 学生非会員